## (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 1. Juli 2004 (01.07.2004)

.. (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/055245 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(22) Internationales Anmeldedatum:

C25D

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/004155

16. Dezember 2003 (16.12.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 102 59 362.0 18. Dezember 2002 (18.12.2002) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DE VOGELAERE,

Marc [BE/DE]; Borkumer Strasse 17, 13581 Berlin (DE). KÖRTVELYESSY, Daniel [DE/DE]; Hohefeldstrasse 6, 13467 Berlin (DE). REICHE, Ralph [DE/DE]; Bulgenbachweg 15, 13465 Berlin (DE). ANTON, Reiner [DE/DE]; Bergahornstrasse 12, 47443 Moers (DE).

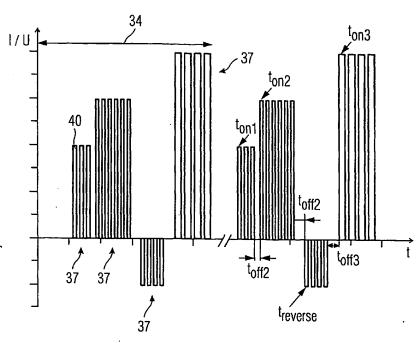
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

## Veröffentlicht:

ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR THE DEPOSITION OF AN ALLOY ON A SUBSTRATE
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ABSCHEIDEN EINER LEGIERUNG AUF EIN SUBSTRAT



(57) Abstract: In previously known electrodeposition methods, alloys can be deposited only badly on a substrate from the components thereof. The inventive method allows an alloy layer to be deposited on a substrate (13) by pulsing the current/voltage used for electrode position.

## 

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Bisherige elektrolytische Abscheidungsverfahren können keine Legierungen nur schlecht aus den Bestandteilen auf ein Substrat abscheiden. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht das Abscheiden einer Legierungsschicht auf ein Substrat (13) durch das Pulsen des zum elektrolytischen Abscheiden verwendeten Stroms/Spannung.